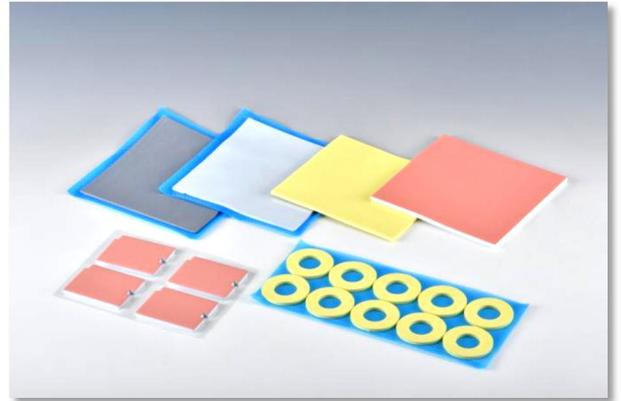


低密度导热垫片

● 产品描述：

TPad-LD 系列 是以有机硅胶为基体，添加特殊处理的导热填料，通过特殊工艺处理的界面导热材料。导热垫片具有较低的密度，低硬度、高变形量等特点。



● 产品特点：

- 1) 良好的双面自粘性
- 2) 高绝缘、高耐温性
- 3) 低密度、低出油

● 应用领域：

- ✓ 车载电子
- ✓ 电源
- ✓ 通讯设备
- ✓ LED设备

● 使用方法：

- ❖ 在导热垫片可根据客户要求裁切或冲切为相应规格尺寸。使用酒精等溶剂清洁接触面，将垫片贴覆于发热界面或散热界面上，并尽量避免气泡产生。

低密度导热垫片

● 典型性能参数:

参数	单位	TPad-1120LD	TPad-1150LD	TPad-1200LD	TPad-1300LD
颜色	----	粉红色	灰色	黄色	灰色
密度	g/cm ³	1.7	1.8	2.0	3.0
硬度	Shore OO	40	40	45	45
体积电阻	Ω·cm	10 ¹³	10 ¹³	10 ¹³	10 ¹³
导热系数	W/m·k	1.2	1.5	2.0	3.0
出油率	%	3.0	3.0	2.0	2.0
击穿电压	KV/mm ac	6.0	6.0	6.0	6.0
拉伸强度	MPa	0.15	0.15	0.12	0.1
阻燃等级	---	V0	V0	V0	V0
保质期	Month	12			

● 包装方式:

标准尺寸 200*400mm/pcs 或 300*400mm/pcs,
厚度 0.5~10mm, 纸箱包装。

● 存储条件:

室温避光保存, 湿度 < 75%